



RE712001-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Ohne Bohrungen
- Heißverzinnt (HAL-leadfree) mit Lötstopplack beschichtet
- Bestückungsdruck
- Platine für 85 SMD Standard-, Fine-Pitch und diskrete Bauelemente:

Typ	Anzahl
PLCC	52, 68, 20
QFP	44, 84, 132, 184 sq.
SOT23	3 x
SOT89	2 x
SOT143	1 x
SOT233	1 x
SO14	1 x
SOM16	1 x
SOL20	1 x
Poti.	1 x
DPAK	1 x
Al. Kond. 6,30 mm	1 x
Al. Kond. 4,00 mm	1 x
Melf 2308	2 x
Mini Melf 1206	6 x
Tantal Chip Kond. A	1
Tantal Chip Kond. B	1
Tantal Chip Kond. C	1
Tantal Chip Kond. D	1
0402 Chip Kond.	10 x
0603 Chip Kond.	10 x
1206 Chip Kond.	10 x
0805 Chip Kond.	10 x
1210 Chip Kond.	7 x
2220 Chip Kond.	1 x
1812 Chip Kond.	2 x
TSOP32	1 x
5020 Schwingquarz	1 x

- Auch sehr gut geeignet zur Maschinenbestückung (Pick & Place)
- Größe 100 x 140 mm

20190909